

华润微电子有限公司

投资者关系活动记录表

(2025 年 6 月)

证券简称：华润微

证券代码：688396

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☒现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	6 月 5 日 华泰证券、兴业证券、合远私募、上海泾溪投资、华宝基金、璞信产融投资、招商局创新投资、嘉实基金 6 月 12 日 中国中金财富证券、华宝证券权益投资部、幸福人寿保险、招商银行、景顺长城基金、成都誉恒投资、大成基金、广东正圆私募、上海艾礼象私募基金、Allwin Fund Management、E20 Capital、FIL HK、Pinpoint、Polymer Capital Management、Torito Capital 6 月 16 日 国信证券、中信里昂证券、平安养老基金、汇添富基金、富国基金、融通基金、Walter Scott
时间	6 月 5 日、6 月 12 日、6 月 16 日
地点	上海、无锡

上市公司接待人员姓名	吴国屹 华润微电子董事、财务总监兼董秘 沈筛英 华润微电子董事会办公室主任
投资者关系活动主要内容介绍	问题一：请问公司目前订单情况及价格趋势？ 答：二季度以来，公司下游需求呈现稳定增长态势，当前订单能见度约为 2-3 个月， 6 吋、8 吋产能利用率已恢复至满载水平。价格方面，整体呈现量增价稳的供需格局。 问题二：请问公司氮化镓产品的最新进展？ 答：公司氮化镓产品可应用于消费电子、工业控制、通讯设备、汽车电子等领域。在技术迭代方面，当前大规模量产的 G3 产品，较上一代在芯片面积、成本控制、性能表现上均有显著提升，Rsp 明显优于行业水平；面向大功率工控领域的 G4 平台产品已陆续进入量产阶段；下一代 G5 平台产品已进入开发阶段，为公司未来竞争力提前做好技术储备。同时，公司氮化镓外延生产基地建设完成，结合公司在晶圆制造及封装领域积累的核心技术优势，将进一步提升公司在氮化镓细分领域的综合竞争力及市场份额。 问题三：请问公司在产品与方案、制造与服务两大业务板块的未来战略布局？ 答：根据公司 2024 年年度报告，产品与方案、制造与服务两大业务板块占营业收入的比例分别为 52%和 48%。规模增长方面，两大板块均具备增长潜力，可通过产能爬坡与利用率提升、产品技术升级、客户结构优化及新兴市场拓展等途径实现。长期发展战略方面，公司以深化 IDM 模式为目标，将逐步提高产品与方案业务收入占比，具体包括持续投入资源进行前瞻产品布局、加速第三代半导体及高性能集成电路发展、加大高端传感

	器布局力度、实施战略性投资并购等。 问题四：请问公司如何看待汽车电子领域的国产化趋势及其带来的机遇？ 答：当前汽车电子产业链仍由国际厂商占据主导地位，但不可忽视的是国内企业的市场份额正在持续提升，国产化替代趋势明确。同时，新能源汽车供应链结构呈现“缩短”趋势，主机厂更倾向于与芯片原厂建立直接合作，进行产品采购及定制化开发，以提升供应链效率与响应速度。在这一背景下，IDM厂商凭借在设计、制造、工艺协同及供应链保障等方面的综合优势，正成为推动国产化进程和满足主机厂需求的重要力量。 问题五：请问公司在 AI 领域有哪些具体的布局？ 答：公司在 AI 领域的布局主要体现在两个方面： 一是 AI 端侧，当前公司主要布局消费电子（包括 AI 手机、AI PC 等）与汽车电子的电动化及智能化应用。同时公司逐步向工业领域拓展，业务覆盖工业机器人、工业自动化等场景。 二是 AI 云端，主要围绕服务器电源提供高性能功率器件解决方案，包括 SGT MOS、SJ MOS、SiC MOS 和 GaN 产品等，目前已实现批量供应。同时公司封装测试服务具备服务器供电管理芯片的量产测试能力，确保芯片性能稳定可靠，PSiP 电源模块和电机驱动模块的封装工艺业内领先，可满足 AI 系统多样化需求。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 6 月